

FINEPLACER® pico 2

多用途贴片机

最强大的实验室及研发工具

- ▶ 多种键合技术(胶粘、焊接、热压、超声)，包括回流焊
- ▶ 全工艺支持，易于编程



支持各种不同的芯片尺寸

高清的工艺过程观测

模块化机器平台允许在整个使用
期内进行现场改造

纯手动或半自动配置版本可选

贴片区域大

优越的性价比

功能

采用固定分光镜的视觉对位系统 (VAS)

可选的红绿蓝三色LED对位灯光照明系统

数据/多媒体记录和报告生成功能

通过触摸屏实现全进程访问和简易可视化编程

工艺模块具有跨Finetech不同设备的高兼容性

可选的工艺模块实现个性化配置

可控贴片压力范围广

具有预定义参数的顺序控制

效益

芯片与基板的精确视觉对准

为所有桌面式贴片机提供出色的结构可视化和最简单的对位进程

全面的工艺文件和工艺参数的可追溯性分析

工艺顺序的快速整合，直观呈现工艺流程

可实现将认证的工艺参数在系统间传输

根据应用需求量身定制的设备解决方案

在一个系统中满足从高到低的贴片压力设定，以满足各种键合技术的要求

以正确的顺序排列所有流程步骤，形成直观且有指导性的工艺流程

技术和方法

- » 烧结
- » 热压焊接
- » 热-/超声键合
- » 焊接/共晶焊接
- » 胶粘贴片

工艺

- » 倒装芯片键合 (正面朝下)
- » 高精度芯片键合 (正面朝上)
- » 晶圆级封装 (FOWLP, W2W, C2W)
- » 2.5D及3D集成电路封装 (堆叠)
- » 芯片到玻璃基板贴装 (CoG)
- » 芯片到柔性基板贴装 (CoF)
- » 玻璃粘合
- » 柔性电路到基板贴装
- » 芯片到基板贴装 (CoB)

应用

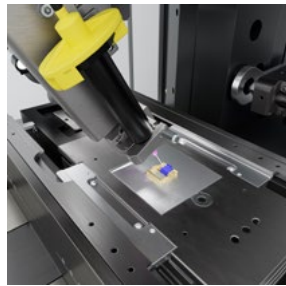
- » X射线探测器组件
- » 喷墨打印头组装
- » 射频识别模块组装
- » 射频/高频模块组装
- » IGBT组装
- » 超声波收发器组装
- » 通用MEMS组装
- » 加速度传感器组装
- » 气压传感器组装
- » 通用MOEMS组装
- » 视觉图像传感器组装
- » NFC器件封装
- » 机械组装

工艺模块 / 增强功能

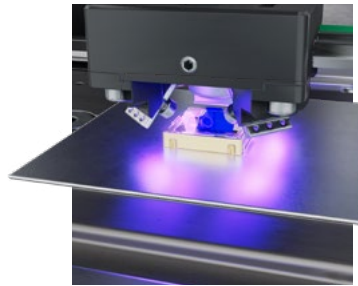
- » 贴片高度间隙调节模块
- » 芯片陈放台
- » 贴片力控制模块(自动)
- » 贴片力控制模块(手动)
- » 相机纵向移动模块
- » 芯片加热模块
- » 元件直接丝印模块
- » 点胶模块
- » 对位符发生器
- » 甲酸模块
- » 自动蘸胶模块
- » 相机横向移动
- » 工艺气体选择
- » 工艺气体模块
- » 工艺观察相机
- » 基板固定
- » 基板加热模块
- » 吸头更换模块
- » 超声模块
- » 紫外固化模块



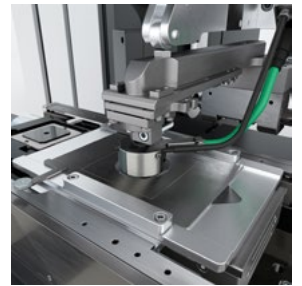
工艺观察相机



点胶模块



紫外固化模块



工艺气体模块



Accuracy

3µm 10µm

Component

min. 0.05 mm x 0.05 mm
max. 100 mm x 100 mm

Substrate

350 mm x 300 mm

Force

0.1N
500N

Operation

manual semi automatic automatic

研发到量产的无缝转换

你有多少前景乐观的产品创意在从研发到量产过程中夭折？你不能持续下去是因为你现有设备的技术限制还是不确定的投资回报？你是否在试图根据生产要求将原型制作工艺向自动化转换的过程中陷入困境？

Finetech“原型到量产”整体解决方案，保证了从研发到量产的1比1工艺转换，保持了完整的技术自由，实现了在短时间内打入市场的同时，将财务风险最小化。



[在此下载本文:](#)



模块化的回报

由于各种工艺和功能模块可供选择，FINEPLACER®支持十分广泛的应用领域。在一开始，这种灵活性的设计完全支持根据当前需求量身定制。此外，系统在其整个使用年限内可以适应新的任务，这是我们设备理念的一个组成部分。各种模块可以方便地组合或交换，这样大大增加了系统的灵活性，并保障了长期投资。

客户反馈

"We use a Finetech die bonder for complex flip chip, sensor and opto-electronics applications, along with co-development of new assembly processes for leading semiconductor customers. The bonder has allowed us to help customers develop, optimize, verify and enhance many state-of-the-art technologies."



Dhiraj Bora
CEO & President, Silitronics

